

규 격 / 사 양 서

1. 개요	품명	두께측정기		
	수량	1	제조사	
2. 용도 및 특징	본 설비는 다양한 반도체 및 금속 박막, 나노 소자 및 반도체 포토레지스트 박막의 두께를 측정하기 위한 장비임. 금속 및 반도체 박막의 두께 및 식각공정을 통해 진행된 박막의 두께 차이를 분석하며, 접촉식 탐침으로 표면을 직접 스캔하여 표면의 단차와 거칠기를 nm 단위로 정밀하게 측정하고 라인 프로파일을 해석하는 장비임.			
3. 기기구성 (세부내용, 수량 등)	- Base System 1대 - 2um 또는 12.5um Stylus tip 1개 - 윈도우 11 – 64비트 데스크탑 컴퓨터 - 23" 평면 모니터 - 인클로저 - 표준시편 : 1um 단차 - S/W : 측정, 단차/거칠기/스트레스 분석 등 - 진동방지테이블			
4. 규격 및 사양	※본 규격은 최소 요구 성능을 정한 것이며, 동등 이상의 성능 및 품질을 갖춘 제품의 납품을 허용함. Measurement Capability: Two-dimensional surface profile measurements; and three-dimensional measurement/analyses Stylus Sensor : Low Inertia Sensor (LIS 3) Stylus Force : 0.03 to 15 mg with LIS 3 sensor Stylus change : Self-aligning stylus fixture, no calibration needed Sample Stage XY : Motorized 150mm, manual leveling Scan Length Range : 55mm; 200mm with scan stitching capability Data Points Per Scan : 120,000 maximum Maximum Sample Thickness : 50mm Step Height Repeatability : 4Å, 1 sigma on steps $\leq 1\mu\text{m}$ (30 scans using a 12.5μm stylus) Vertical Resolution : 1Å (@ 6.55μm range) TCP/IP Runtime Control Server			
5. 설치, 교육 및 사후관리	숙련된 엔지니어의 장비 설치 및 시험가동 진행			
6. 품질보증 기간 (Warranty)	1년			
7. 납기일자	계약체결일로부터 3개월 이내			

8. 계약업체 제출서류	
9. 참가자격	
10. 참가자격 제출서류	
11. 기타사항	화공신소재공학과 / 이병훈 교수님 / leebhoon@ewha.ac.kr 담당자: 김민재 연구원 nfs0709@ewha.ac.kr